

『フリップチップ実装システム』

高速、高信頼性、省スペース、低価格……。

これらの理想を全て実現したのが、
TDKの「Flip Chip 実装システム」。

電子部品メーカーのTDKが、
お客様視点で生産現場が求めている
ニーズを掘り起こし、
製品化したシステムです。

フリップチップボンダ業界
最高パフォーマンス
(小型・中型デバイスに最適)

AFM-15

(熱・超音波接合 等)
タイプ名: 1505, 1506, 1561 等

特長

- ① 業界最高実装タクト
0.72sec/チップ
(プロセス時間0.2sec含)
- ② 業界最高実装精度
($\pm 7\mu\text{m}/3\sigma$, オプションMax $\pm 3\mu\text{m}/3\sigma$)
- ③ 業界最小装置サイズ(0.99m²)
- ④ 低エネルギー接合
- ⑤ 12インチウエハ供給対応
- ⑥ ハイクリーンレベル

高精度マウンタの提案

AFM-15D

タイプ名: 1505D, 1506D, 1561D 等

特長

- ① 高精度マウンタ (Face Up実装)
- ② 大型基板対応 (Max 12inchウエハ)
- ③ 業界最高実装精度($\pm 5\mu\text{m}/3\sigma$, オプションMax $\pm 3\mu\text{m}/3\sigma$)
- ④ あらゆるプロセスを考慮した柔軟設計 (樹脂塗布、UV照射 等)



生産現場のニーズを
お客様視点で凝縮。

高精度・微量・定量塗布用途に最適

MDM-50

高精度ディスペンサ

特長

- ① 業界最高定量塗布の実現
- ② 業界最高ノズル位置精度($\pm 3\mu\text{m}$)
- ③ 業界最小装置サイズ(0.71m²)
- ④ トレサビリティを考慮したディスペンスモニター



■概略基本仕様

モデル		AFM-15			MDM-50
タイプ		1505	1506	1561	—
方式		Face Down フリップチップ (オプション: Face Up 高精度マウント)			①メカニカル ②非接触ジェット ③エア圧縮方式
接合法		熱・超音波・C4・熱圧着 等			(塗布)
対象製品		LED, CMOSセンサー, TCXO, SAW, 光, RFモジュール 等 各種デバイス			
実装スピード		MAX : 0.78sec/チップ (プロセス時間0.2sec含)	MAX : 0.72sec/チップ (プロセス時間0.2sec含)	MAX : 1.6sec/チップ (プロセス時間0.4sec含)	—
対象基板		±7μm/3σ (オプション±5μm, ±3μm)		±5μm/3σ	±3μm
最大荷重		25N (オプション: 50N, 100N)		50N (オプション: 100N)	(最大ヘッド数: 4)
対象チップ	サイズ	MAX : 2.5W x 2.5D x 1.0T mm MIN : 0.3W x 0.3D x 0.1T mm (オプション MAX : 7.0W x 7.0D mm)		MAX : 7.0W x 7.0D x 1.0T mm MIN : 2.5W x 2.5D x 0.1T mm	—
	供給形態	5,6,8,12インチウエハ, トレイ等 (ウエハマガジン自動ローダ)	5,6インチウエハ, トレイ等 (ウエハリング半自動ローダ)	8,12インチウエハ等 (ウエハマガジン自動ローダ)	—
対象基板	サイズ	MAX : 180W x 120D x 3.0T mm MIN : 50W x 50D x 0.3T mm (オプション MAX : 8 インチウエハ基板)	MAX : 170W x 105D x 3.0T mm MIN : 50W x 50D x 0.3T mm	MAX : 180W x 120D x 3.0T mm MIN : 50W x 50D x 0.3T mm (オプション MAX : 12 インチウエハ基板)	MAX : 170W x 150D x 2.0T mm MIN : 30W x 30D x 0.3T mm (オプション MAX: 315W 300D mm)
	供給形態	基板・個片トレイ・ウエハトレイ 等			
装置	サイズ	1,200W x 1,450D x 1,650H mm	980W x 1,020D x 1,860H mm	1,980W x 1,620D x 1,566H mm	710W x 995D x 1,500H mm
	重量	約 1,800 kg	約 1,500 kg	約 2,100 kg	約 600 kg
標準搭載機能		予熱・実装テーブル(加温) ノズル自動クリーニング 超音波出力管理 チップ高さ測定 バンプ検出・パッドマーク検出 ウエハθ補正・ウエハエキスパンド・ウエハホットブロー ノズル裏面モニタリング・ノズルボンディングカウンター LAN対応 生産管理情報			予熱・塗布テーブル(加温) 各種塗布モード ノズル自動クリーニング 高さ検出(接触式) 重量測定器 パッドマーク検出 LAN対応 生産管理情報
オプション 及び 特殊機能		マガジン・ローダー・アンローダ ヘパフィルタ 除電ブロー(イオナイザ) プロファイルモニター チップトレイ対応 マップデータ 実装ノズル加熱 基板(パッケージ)特殊押さえ 実装前検査・後検査 実装ノズル研磨治具 各種(小型チップ, 大型チップ用) 超音波ホーン ポストテーブル(加温) 樹脂転写ユニット 微量塗布ユニット UV照射ユニット 他			マガジン・ローダー・アンローダ ヘパフィルタ ポストテーブル(加温) ディスペンスモニター 高さ検出(非接触式) 各種(メカニカル, JET, AIR) 塗布ヘッド 複数ヘッド搭載(最大4) 異種ヘッド搭載(最大2)

●上記基本仕様外につきましては、遠慮なく御相談下さい。

●製品の定格及びデザインは改善等のために、予告なく変更する場合があります。

TDK株式会社

生産技術グループ 営業推進部

〒272-8558 千葉県市川市東大和田2-15-7

TEL.047-378-9226 FAX.047-378-9242

<http://product.tdk.com/ja/products/fa/>



※このパンフレットは、森林認証紙を使用しています。